

SAP

R&D

Semi-Additive Process

特長 Features

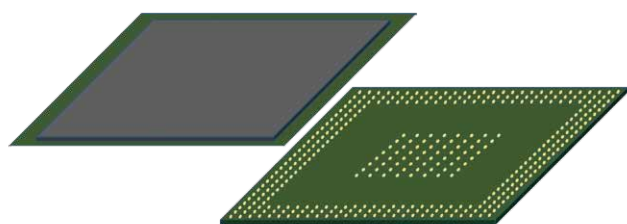
- 高精細パターン形成
High definition pattern formation

用途 Application

- FC-BGA パッケージ基板
FC-BGA package PCB

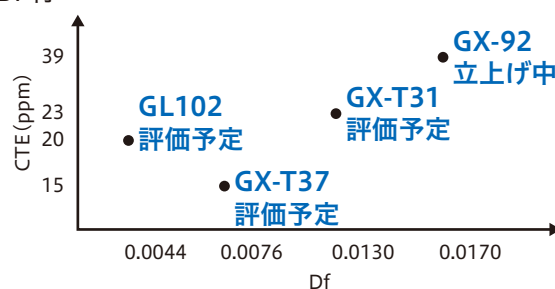
Package基板例 Package PCB

CPU基板 CPU PCB



適用材料 Materials

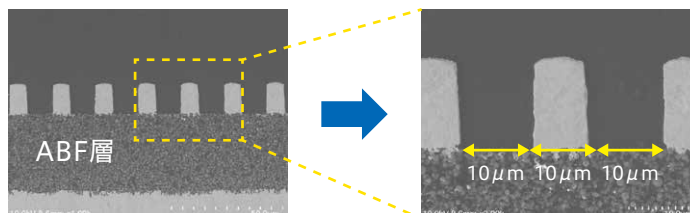
ABF材 ABF material



パターン形成 Pattern formation

ABF layer

Target L/S = 10/10μm



RoadMap

			2023FY			2024FY			2025FY		
			1st half	2nd half	development	1st half	2nd half	development	1st half	2nd half	development
L/S	BU layer (ABF)	外層 Outer layer	15/15	15/15	9/12	9/12	9/12	8/8	8/8	8/8	5/5
		内層 Inner layer	15/15	15/15	9/12	9/12	9/12	8/8	8/8	8/8	5/5
	Core layer	外層 (Cu23) Outer layer	50/50	50/50	45/45	45/45	45/45	40/40	40/40	40/40	35/35
		内層 (Cu23) Inner layer	50/50	50/50	45/45	45/45	45/45	40/40	40/40	40/40	35/35
LVH	BU layer (ABF)	LVH径 LVH Diameter	φ50	φ50	φ40	φ40	φ40	φ40	φ40	φ40	φ35
		ランド径 Land diameter	φ100	φ100	φ80	φ80	φ80	φ75	φ75	φ75	φ70
IVH	Core layer	ドリル径 Drill diameter	φ150	φ150	φ120	φ120	φ120	φ100	φ100	φ100	φ100
		ランド径(外層) Land diameter (Outer layer)	φ250	φ250	φ220	φ220	φ220	φ200	φ200	φ200	φ200
SR		開口径 Opening diameter	φ80	φ80	φ70	φ70	φ70	φ60	φ60	φ60	φ50